

國立中央大學八十八學年度碩士班研究生入學試題卷

所別：光電科學研究所 不分組 科目：材料工程 共 / 頁 第 / 頁

1. 什麼是材料的硬度（hardness）？請以宏觀及微觀的角度說明之。硬度如何測量？（15%）
2. 以冰塊加食鹽可作為冰淇淋，請以相圖說明其道理。（15%）
3. 假設：固体中的電子、原子之熱力學性質遵從 Boltzmann distribution，
 $n/N \propto e^{-(E-E_{av})/kT}$
k : Boltzmann constant ($=13.8 \times 10^{-24} \text{ J/atom K}$ or $=86.1 \times 10^{-6} \text{ eV/K}$)
n : 擁有能量為 E 的原子數
N : 總原子數
 E_{av} : 原子的平均能量
(A) 某晶体在 500°C 作擴散實驗，觀察每 10^{10} 原子會有 1 顆原子得到足夠的激活能量（activation energy）而從其晶格跳到晶格間位置（interstitial site）。又在 600°C 時同樣實驗顯示其比例增加到 10^9 。
(i) 請利用此實驗結果推算出其激活能量。
(ii) 若溫度增到 700°C ，又有多少原子會被激活而跳到晶格間的位置？
(B) 不含雜質的本質半導體銻（intrinsic Ge）其電導性來自於導帶的電子及價帶的空穴（hole）。實驗發現在 20°C 的電阻率（resistivity）為 0.5 ohm m 。請問在 40°C 時電阻率為多少？
(20%)
4. 解釋 edge dislocation 及 screw dislocation。（10%）
5. 何謂 intrinsic semiconductor 及 extrinsic semiconductor，並舉例之。（10%）
6. 說明 solution hardening 及 strain hardening。（10%）
7. 在 steel 中，有所謂的 eutectoid shift，請說明並舉例之。（10%）
8. 解釋 ceramic process 中之 sintering process。（10%）

